

Technical Data Sheet 低温固化环氧胶

SE611 是一款无溶剂型单组分环氧胶，可在 80℃ 条件下快速固化，具备低收缩率、高粘接强度的特点，同时拥有良好的韧性、绝缘性能与耐高低温冲击能力，适配多种低温固化工艺场景。

主要用途

- 无刷电机马达引线固定、LED 背光灯珠、电子元器件、家用手持电器等粘接场景；
- 适用于工业电子电器领域中无法承受高温固化、需 100℃ 以内完成固化的应用。

产品特性

- 80℃ 即可快速固化，固化收缩率低；
- 韧性优异，绝缘性能佳，粘接强度高；
- 耐高低温冲击性能出色。

技术参数

性能	标准	指标
颜色	目测	黑色
外观	目测	半流淌
粘度 mPa·s	GB/T 2794-1995	20000±5000
密度 g/cm ³	GB/T 13354-1992	1.4±0.1
固化条件	GB/T 10247-2008	95℃/15min; 80℃/30min

硬度 Shore D	GB/T 2411-1980	80±5
玻璃化转变温度 Tg °C	ASTM E1545	40
铝 - 铝 拉伸剪切强度 MPa	GB/T 7124-1986	> 10
热膨胀系数 PPM/°C	GB/T 1036-1989	45 (< Tg) ; 135 (> Tg)
吸水率 % (24H@25°C)	GB/T 1034-1998	0.16
介电常数 / 介电损耗 1KHz	GB/T 1693-2007	3.3/0.02
介电常数 / 介电损耗 100KHz	GB/T 1693-2007	3.0/0.03
介电强度 kV/mm	GB 1408.1-1999	26.5
表面电阻 Ω	GB/T 1410-2006	1.9×10 ¹⁶
体积电阻 Ω·cm	GB/T 1410-2006	5.2×10 ¹⁵
使用温度范围 °C	--	-40~120
保质期 (-10°C低温密封)	--	6 个月

以上数据为 80°C 固化 30min 后的标态检测数据。

使用说明

1. 使用前必须将产品恢复至室温，回温前请勿打开包装，建议回温时间大于 4 小时。基材表面需保持清洁干燥，去除油污、灰尘、氧化层及其他污染物，确保粘接面洁净。
2. 粘接完成后，工件应在 0.1-0.5kg/cm² 的压力下进行固化，推荐固化条件为 95°C 保温 1 小时。若粘接基材不同、固化条件调整，或存在其他超出指标范围的情况，建议先开展验证实验，或联系技术人员确认适配参数。

储存须知

建议低于 5℃密封储存，贮存期 6 个月。

包装及运输

包装规格

50ml / 支，1kg / 桶，5kg / 桶。

运输要求

产品属于非危险品，可按一般化学品（低温存储类）运输。运输过程中需防潮、防雨淋、防晒、防高温，远离热源，小心轻放，禁止挤压碰撞。

安全注意事项

远离儿童存放，建议在通风良好的场所内使用。

禁食，本品固化前应避免与眼睛、皮肤接触。如不慎接触皮肤，先用肥皂水或酒精擦洗，再用清水冲洗；如不慎接触眼睛，先用大量清水冲洗，必要时立即就医。

产品安全资料可从 SEPNA 及各分销商处获得，也可通过邮件或服务电话咨询获取。

特别说明

本资料表中的产品性能与使用信息均为标准条件下测得。由于使用条件存在差异，使用者有责任根据自身应用场景对产品进行测试验证。除非 SEPNA 出具针对特定需求的书面证明，否则 SEPNA 仅保证产品符合销售说明书所列规范，不担保其他特定用途。若产品未达到所列要求，SEPNA 的唯一责任为退款或换货，不承担任何意外事故与间接损失责任。

VERSION 1.0/ 2025-03

SERVICE HOTLINE:400-882-1323

E-MAIL:sepna@sepna.cc

WWW.SEPNA.CC